

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年10月7日(07.10.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/199919 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/56 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/008786

(22) 国際出願日: 2021年3月5日(05.03.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2020-061027 2020年3月30日(30.03.2020) JP

(71) 出願人: 三井化学東セロ株式会社
(MITSUI CHEMICALS TOHCELLO, INC.) [JP/
JP]; 〒1018485 東京都千代田区神田美
土代町7 Tokyo (JP).

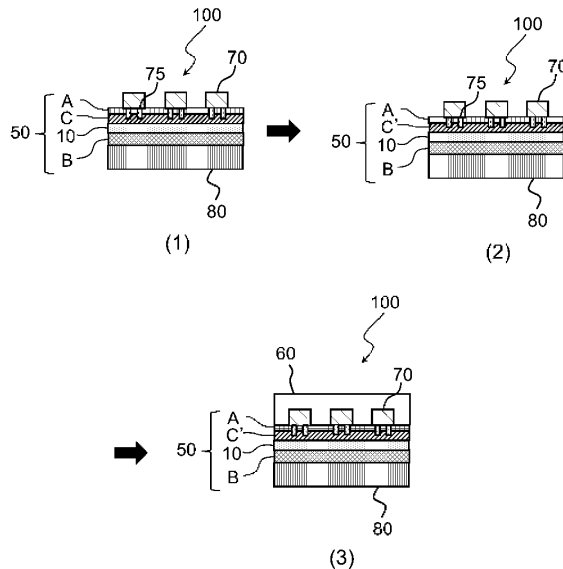
(72) 発明者: 三浦 徹(MIURA Toru); 〒4570801 愛
知県名古屋市南区丹後通2-1 三井化
学東セロ株式会社内 Aichi (JP). 栗原 宏
嘉(KURIHARA Hiroyoshi); 〒4570801 愛知県
名古屋市南区丹後通2-1 三井化学東
セロ株式会社内 Aichi (JP).

(74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI Shinji); 〒1410031
東京都品川区西五反田7丁目9番2号 K
DX五反田ビル9階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: 電子装置の製造方法



(57) Abstract: A method for producing an electronic device, said method comprising at least: a preparation step for preparing a structure (100) which is provided with a base material layer (10), an adhesive film (50) that comprises an adhesive resin layer (A) which is provided on a first surface (10A) side of the base material layer (10) for the purpose of provisionally affixing an electronic component (70), an adhesive resin layer (B) which is provided on a second surface (10B) side of the base material layer (10), and a relief absorbing resin layer (C) which is provided between the base material

[続葉有]

WO 2021/199919 A1

HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

layer (10) and the adhesive resin layer (A) or between the base material layer (10) and the adhesive resin layer (B), while being able to be crosslinked by means of an external stimulus, and an electronic component (70) that is bonded to the adhesive resin layer (A) of the adhesive film (50), while having a relief structure (75); a crosslinking step for crosslinking the relief absorbing resin layer (C) in the structure (100) by applying an external stimulus to the relief absorbing resin layer (C); and a sealing step for sealing the electronic component (70) by means of a sealing material (60).

(57) 要約: 基材層(10)と、基材層(10)の第1面(10A)側に設けられ、かつ、電子部品(70)を仮固定するための粘着性樹脂層(A)と、基材層(10)の第2面(10B)側に設けられた粘着性樹脂層(B)と、基材層(10)と粘着性樹脂層(A)との間または基材層(10)と粘着性樹脂層(B)との間に設けられ、かつ、外部刺激により架橋可能な凹凸吸収性樹脂層(C)と、を備える粘着性フィルム(50)と、粘着性フィルム(50)の粘着性樹脂層(A)に貼り付けられ、かつ、凹凸構造(75)を有する電子部品(70)と、を備える構造体(100)を準備する準備工程と、構造体(100)中の凹凸吸収性樹脂層(C)に対して外部刺激を与えることにより、凹凸吸収性樹脂層(C)を架橋する架橋工程と、封止材(60)により電子部品(70)を封止する封止工程と、を少なくとも備える電子装置の製造方法。